

## 低圧 RF スパッタ装置

HVS-02 / HVS-03

高真空対応のスパッタガンを用いることにより、 $10^{-2}$ Pa 台においても薄膜形成が可能です。

最高 5 元までのスパッタガンの設置が可能です。

- |                |  |
|----------------|--|
| ■ 製膜室チャンバ      | 到達圧力： $6.5 \times 10^{-6}$ Pa<br>基板サイズ：Φ2 インチ × 1 枚 (HVS-02)<br>Φ3 インチ × 1 枚 (HVS-03)<br>基板加熱方式：抵抗加熱方式<br>基板加熱温度：Max.700℃<br>基板回転機構：Max.20rpm<br>Z 軸移動機構：±20mm |
| ■ 低圧 RF スパッタガン | ターゲットサイズ：2 インチ<br>回転シャッター機構  |
| ■ RF 制御電源      | 300W、13.56MHz、オートチューニング式   |
| ■ 投入室          | 到達圧力： $6.5 \times 10^{-5}$ Pa<br>基板搬送：手動トランスファーロード方式   |

